

P2001,0292

BOX AF

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant	: Harald Gundlach	Confirmation No.	3521
Applic. No.	: 10/694,601		
Filed	: October 27, 2003		
Title	: CHIP CARD MODULE		
Examiner	: Kimberly D. Nguyen	Group Art Unit	: 2876
Docket No.	: P2001,0292		
Customer No.	: 24131		

DECLARATION UNDER 37 C.F.R. § 1.131

The undersigned, Harald Gundlach, inventor of this invention, hereby declares that:

The invention of the above-identified application was "conceived" and "reduced to practice" in one of the United States, a NAFTA country other than the United States, or a WTO member country at least as early as February 28, 2001.

The undersigned, Harald Gundlach, developed CHIP CARD MODULE according to the invention and wrote the Invention Disclosure (Erfindungsmeldung).

Enclosed, as corroborating evidence, is the Invention Disclosure which is a pre-printed form signed by the undersigned. The Invention Disclosure was executed by the undersigned on November 24, 2000 (see signatures on the bottoms of page 4). The Invention Disclosure was given to Mr. Weißhuhn, who is the inventors' superior, on November 29, 2000. On the right side in the upper half of the first page there is a box that indicates when the Invention Disclosure was received by the inventors' superior. This box is labeled "*Eingang am:*" (Received on) and the date "29.11.2000" is handwritten in this box. As is customary in Europe, the order of the handwritten date is day/month/ year.

The Invention Disclosure was shortly thereafter further submitted to the corporate patent department of Siemens Aktiengesellschaft and it was received, as best understood, on January 23, 2001 (see the lower right corner of page 1).

The undersigned hereby declare that all statements made herein of his own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Harald Gundlach

Date

Vertraulich! Bitte verschlossen weitersenden!	ERFINDUNGSMELDUNG an die Siemens AG / Infineon AG bzw. Beteiligungsgesellschaft		Aktenzeichen der PA <div style="text-align: right; font-family: monospace; font-size: 1.2em;">2001 E 01208 DE</div>
Ich/Wir (Vor- und Nachname der/des Erfinder[s] - weitere Angaben und Unterschrift(en) letzte Seite) Dr. Harald Gundlach	Anzahl der Erfinder: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">1</div>	Datum der Ausfertigung: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">24.11.00</div>	
melde[n] hiermit die auf den folgenden Seiten vollständig beschriebene Erfindung mit der Bezeichnung: Tastatur für System-on-Card – sowie allgemein Bauteilintegration für System-on-Card			
I. An Vorgesetzten der/des Erfinder[s] Herrn/Frau <u>Weißhuhn</u> CC PC <small>(Dienststelle)</small> mit der Bitte, die nachstehenden Fragen zu beantworten: a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein? → b) Geht die Erfindung auf öffentlich geförderte Arbeiten zurück? <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Vorhaben: _____ c) Gibt es ein zugehöriges internes FuE-Projekt? <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Projekt: _____			Eingang am: <div style="text-align: center; margin-top: 20px; font-family: monospace; font-size: 1.2em;">29.11.00</div>
Nur bei ZT-Erfindungen auszufüllen: Projekt-Nr. _____ Titel: _____ Kerntechnologie: _____ <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> Entwicklungsprojekt <input type="checkbox"/> Forschungsprojekt </div> im Interesse von Bereich: _____ Ansprechpartner: _____			
d) Anmeldung wird empfohlen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Dringlichkeitsvermerk <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">CC PC</div> Kosten trägt (Organisationseinheit): _____ <input type="checkbox"/> Die Erfindung betrifft nicht unser Interessengebiet. Es sind noch folgende Dienststellen zu befragen: _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">14.12.00 <small>(Datum)</small></div> <div style="text-align: center;"> <small>(Unterschrift des Vorgesetzten)</small> </div> </div>			Jörn Gebert 15. DEZ. 2000
II. Bitte wegen gesetzlicher Frist sofort weiterleiten an CC M CM Jörn Gebert Mich M zur weiteren Veranlassung.			Eingang am: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> ZT GG VM Mch P/Ri Eing. 23. Jan. 2001 GR </div>

19a

IFX 16

1. Welches technische Problem soll durch Ihre Erfindung gelöst werden?
2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?
3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)?
4. Worin liegt der erfinderische Schritt?
5. Ausführungsbeispiel[e] der Erfindung.

1. Welches technische Problem soll durch die Erfindung gelöst werden ?

Für ein System-on-Card soll eine dünne Tastatur geschaffen werden, die möglichst kostengünstig sein soll.

2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst ?

Bisherige Tastaturen sind zu dick, als dass sie in eine normal dünne Chipcard integriert werden können. Sie bestehen aus einer Deck- und einer Basisfolie sowie dazwischenliegenden Schalteilen, die meist ebenfalls in eine Folie eingesetzt sind.

P2001, 0102

3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene Problem ? (Vorteile ?)

Die EFM „...“ von Dr. Müller / Dr. Gundlach bzw. „...“ von Stampka / Dr. Gundlach erwähnt schon dass die Komponenten auf einen Zwischenträger gesetzt werden, der entweder in oder auf der Außenseite der Karte liegt.

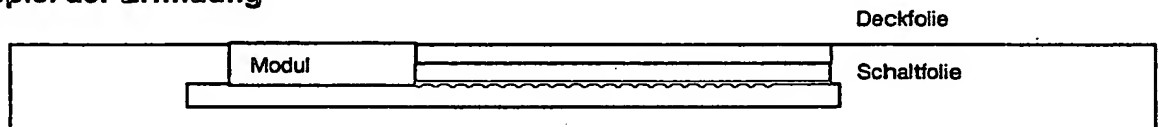
Durch Integration dieses Zwischenträgers in die Tastatur entsteht ein Aufbau, der dünn genug für eine Integration in die Karte ist: Z.B. kann die Basisfolie entfallen, wenn die erforderlichen Leiterbahnen auf dem Zwischenträger vorgesehen werden. Nur die übrigen Teile der Tastatur sind dann noch in die Karte zu montieren.

4. Worin liegt der erfinderische Schritt ?

Integration von Basisträger oder Zwischenträger des System-on-Card und einem Bestandteil der Tastatur

Dieses Prinzip der Integration kann auch auf andere Bauteile angewendet werden, wie z.B. Module, deren Substrate ein Stück mit der Abdeckfolie eines Displays sind.

5. Ausführungsbeispiel der Erfindung

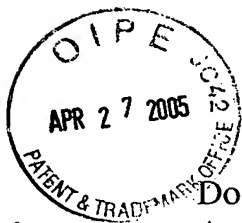


Auf den Basisträger der Tastatur wurde verzichtet ! Hierdurch kann Höhentoleranz eingehalten werden und es können Folientastaturen eingesetzt werden, die von Handy-Tastaturen abgeleitet werden.

6. Zur weiteren Erläuterung sind als Anlagen beigefügt:

- 0 Blatt der Darstellung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung;
(falls möglich, Zeichnungen im PowerPoint- oder Designer-Format anfertigen)
- Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle);
- Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt; *)
- sonstige Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zeichnungen der Ausführungsbeispiele):

*) Bitte Fotokopien oder Sonderdrucke aller zitierten Veröffentlichungen (Aufsätze vollständig; bei Büchern die relevanten Kapitel) mit vollständigen bibliographischen Daten beifügen.




Docket No.: P2001,0292

Application No.: 10/694,601

CERTIFICATION

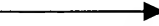
I, the below named translator, hereby declare that: my name and post office address are as stated below; that I am knowledgeable in the English and German languages, and that I believe that the attached text is a true and complete translation of pages 1/4 and 2/4 of the invention disclosure 2001 E 01208 DE, dated November 24, 2000.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Hollywood, Florida

Birgit Bartell

April 25, 2005

Lerner & Greenberg, P.A.
P.O. Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel.: (954) 925-1100
Fax.: (954) 925-1101

Confidential! Please forward sealed	Invention Disclosure to Siemens AG / Infineon AG or or affiliated company	Docket No. of PA 2001E01208DE
I/We (first and last name of the inventor(s) – further data and signature(s) last page) Dr. Harald Gundlach	Number of Inventors 1	Date of draft 24-Nov-2000
herewith report the invention fully described on the following pages entitled: Keyboard for System-on-Card as well as general assembly integration for System-on-Card.		
I To the inventor(s) Supervisor Mr./Mrs. <u>Weißhuhn</u> <u>CCPC</u> (Department) with the request to answer the following questions: a) When did you receive the invention disclosure?  b) Can the invention be traced back to publicly sponsored operations? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes, (intention) c) Is there an appertaining internal FuE-project? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes, project _____	Date of Receipt 29-Nov-2000 Statutory due date runs from the date of receipt	
Only to be filled out for ZT Inventions: Project No.: _____ Title _____ Nuclear Technology _____ <input type="checkbox"/> Developing Project Area of Interest: _____ Contact Person _____ <input type="checkbox"/> Research Project		
d) Application is recommended <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Yes Urgent Note The cost is borne by (Organizational Unit) <u>CCPC</u> <input type="checkbox"/> The invention does not lie in our field of interest. The following departments must be questioned: _____ <u>14-Dec-2000</u> Date _____ Supervisor's Signature _____	Date of Receipt Jörg Gebert 15-Dec-2000	
II. Please forward immediately because of statutory due date CC M CM Jörg Gebert Mch M for further processing	Received on: ZT GG VM Mch P/Ri Receipt: 23-Jan-2001 GR	

1. Which technical problem is to be solved with your invention?
 2. How has this problem thus far been solved?
 3. In which way does your invention solve the technical problem indicated (please indicate advantages)?
 4. Where does the inventive step lie?
 5. Embodiments of the invention
-
1. Which technical problem is to be solved with the invention?
A thin keyboard being as cost-efficient as possible is to be created for a System-on-Card.
 2. How has this problem been solved thus far?
Present keyboards are too thick in order to be able to be integrated into a normal thin chipcard. They consist of a covering foil and base foil as well as switch elements therebetween which are mostly inserted into a foil also.
 3. In which way does your invention solve the problem indicated? (Advantage?)
The "EFM ..." by Dr. Müller / Dr. Gundlach or "..." by Stampka / Dr. Gundlach already mentions that the components are arranged on an intermediate carrier which is either in or on the outer side of the card.

By integrating the intermediate carrier into the keyboard, an assembly results which is thin enough for insertion into the card; for example, the base foil can be eliminated if the necessary conductor tracks are provided on the intermediate carrier. Only the remaining parts of the keyboard are yet to be mounted into the card.

4. Where does the inventive step lie?
Integration of base carrier or intermediate carrier of the System-on-Card and a component of the keyboard.

This principle of integration can also be applied to other components, such as modules, the substrates of which are part of the covering foil of a display.

5. Embodiment of the invention
- | | |
|--------|---------------|
| | Covering Foil |
| Module | Switch Foil |

One renounced on the base carrier of the keyboard! This allows the maintenance of height tolerance as well as the insertion of foil keyboards, which are derived from handy keyboards.

6. For further explanation, enclosed are:
 - _____ illustration page of one or more embodiments of the invention;
(if possible, drawings prepared in power-point or designer format)
 - _____ sheet with additional descriptions (for instance, lab experiments, test reports)
 - _____ sheet with literature describing the state of the art from which the invention proceeds;
 - _____ other documents (for instance, diskettes, in particular with drawings of the embodiments)

Page 3/4 contains irrelevant information and page 4/4 contains confidential inventor information. Both pages are therefore not submitted.